

8月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、宏观动态..... 5

 (一) 行业政策..... 5

 (二) 经济指数..... 7

二、半导体产业动态..... 12

 (一) 短期影响..... 13

 (二) 中期影响..... 14

 (三) 长期影响..... 15

三、终端市场动态..... 17

 (一) 人工智能..... 18

 (二) 新能源..... 18

 (三) 消费电子..... 18

 (四) 工业电子..... 19

 (五) 汽车电子..... 19

 (六) 通信电子..... 19

 (七) 医疗电子..... 20

四、重点产品行情..... 21

 (一) 存储芯片..... 21

 (二) GPU..... 22

 (三) CPU..... 24

信息来源..... 26

免责声明..... 29

摘要

2025 年 8 月重点行情趋势	
宏观动态	● 美国拟对进口半导体加征高额关税 ● 美国政府考虑以股权换取补贴 ● 韩国推出 45.8 万亿韩元支持计划，强化半导体供应链 ● 中国网信办约谈科技企业，推动国产 AI 芯片替代 ● 日本 Kanto Denka Kogyo 氮三氟化物工厂火灾引发半导体气体供应不稳定
产业动态	● 短期影响：寒武纪/海光信息国产芯片概念股集体高开，市场情绪高涨；三星电子 HBM4 通过英伟达验证，计划 8 月底预生产；SK 海力士 HBM3E 需求爆发，营收贡献显著；美光裁员并削减成本，聚焦 HBM 与高毛利内存；英伟达推出 Jetson AGX Thor 平台 ● 中期影响：瑞萨电子发布 RZ/G3E MPU 与 RA8P1 MCU，面向工业/人机界面与高性能控制；Deepseek 发布 DeepSeek-V3.1，明确支持 FP8 精度；微软 Windows 11 更新致部分 SSD “掉盘”；意法半导体发布 Q2 业绩并重申收购 NXP 传感器条款，MEMS 维持两位数增长；恩智浦 Q2 业绩优于预期，并推进传感器业务出售 ● 长期影响：华为实现麒麟芯片全产业链国产化；台积电两年内逐步退出 6 英寸产线、集中资源于 12 英寸与先进封装/制程；英伟达 Blackwell/Rubin 代际切换与中国区合规变体节奏，将重塑 AI 供应链配额
终端市场	● 人工智能：英特尔获软银 20 亿美元投资，加码 AI 芯片与代工制造；谷歌将在美追加 90 亿美元，扩建云计算与 AI 基础设施 ● 新能源：阳光电源拟在阿曼建设氢能电解槽工厂，布局中东氢能市场；长安汽车计划在欧洲建厂，加速全球化布局 ● 消费电子：小米发布 2025 年 Q2 财报，智能手机全球市场份额达 14.7%；智元机器人获富临精工数千万元订单，工业具身智能迈向规模化商用阶段 ● 工业电子：工业富联 2025 上半年业绩创新高，净利润增长 38.6% ● 汽车电子：豪恩汽电拟定增募资不超过 11.05 亿元，扩建深圳、惠州产线 ● 通信电子：中国移动 51.12 亿元 AI 推理设备集采落定，中兴通讯等企业 ● 医疗电子：迈瑞医疗武汉基地正式开园，总投资达 45 亿元
产品行情	● 存储芯片：8 月存储芯片全线涨价，供给端呈现结构性调整 ● GPU：产品迭代加速，AI GPU 租赁与替代趋势显著 ● CPU：服务器 CPU 压力攀升启动价格战，消费级市场供需分化

一、宏观动态

（一）行业政策

● 美国拟对进口半导体加征高额关税

美国总统特朗普于 8 月 15 日宣布, 计划在 8 月 18 日至 29 日期间公布对进口半导体芯片加征关税的方案, 税率可能高达 200% 甚至 300%, 远超市场此前预估的 100%。该政策以"国家安全"为由推进, 旨在通过极高关税迫使全球芯片企业将产能转移至美国, 减少对外部供应链的依赖, 但同时也引发了全球半导体相关股票及 ETF 的明显波动, 市场对供应链重构与成本上升的担忧迅速升温。特朗普明确表示将设立豁免机制, 承诺在美国投资建厂的企业可获得关税豁免, 苹果公司因已宣布追加 100 亿美元、累计达 600 亿美元的本土制造投资, 被视为潜在受益者之一。

● 美国政府考虑以股权换取补贴

美国商务部长霍华德·卢特尼克正研究一项计划, 让联邦政府对那些获得《芯片法案》(CHIPS Act) 资金补助、并承诺在美国建造芯片工厂的行业巨头持有股权。此举被视为"以股换补", 旨在确保美国就业与投资不被外移, 目前除与英特尔商洽美国政府持有其 10% 股权外, 也评估对美光、台积电与三星等主要受补助企业进行类似股权投资安排。这一模式可使美国政府降低直接财政支出压力, 又能以"股东"身份参与决策, 分享产业增长红利。

● 韩国推出 45.8 万亿韩元支持计划, 强化半导体供应链

韩国政府于 8 月 20 日宣布推出总额为 45.8 万亿韩元 (约合人民币 2349.54 亿元) 的支持计划, 以增强供应链弹性。该计划结合低利率融资和公私基金, 重点支持电池、半导体、关键矿产、能源、制药与生物技术以及物流基础设施等六大关键产业。资金安排包括: 供应链稳定基金出资 10 万亿韩元, 韩国进出口银行提供 13.3 万亿韩元, 韩国产业银行承担 18 万亿韩元, 中小企业银行配套 4.5 万亿韩元。此外, 还将设立两支联合投资工具: 规模为 1.8 万亿韩元的基金聚焦龙头企业, 6000 亿韩元的基金则专门支持材料、零部件和设备领域的中小企业。

● 日本 Kanto Denka Kogyo 氮三氟化物工厂火灾引发半导体气体供应不稳定风险

2025 年 8 月, 日本 Kanto Denka Kogyo 公司位于其氮三氟化物 (NF_3) 工厂发生火灾, 导致氮三氟化物的生产受阻, 引发了全球半导体产业对气体供应链稳定性的广泛关注。 NF_3 是芯片刻蚀和钨六氟化物生产中的关键材料, 而 Kanto Denka Kogyo 是该领域少数几家主要生产商之一, 此次事件可能导致全球半导体生产的中断与延迟, 进而影响芯片制造的整体进程。

尽管对于一线制造商如台积电（TSMC）而言，因其供应商多样化的策略，其短期内的生产受到的影响较小，但这一事件对日本半导体产业的潜在影响尤为严重。特别是对于新兴半导体厂商 Rapidus 而言，Kanto Denka Kogyo 在氮三氟化物市场中占据约 90% 的市场份额，火灾可能导致其供应链遭遇较大挑战，进而影响到该公司在日本半导体行业的竞争力。

此次火灾事件再次凸显了半导体产业链中对关键原材料的高度依赖问题，尤其是气体供应的脆弱性。随着全球半导体产业对材料供应的要求日益增加，供应链的多元化和安全性成为行业未来发展的关键议题。

- **中国网信办约谈科技企业，推动国产 AI 芯片替代**

中国国家网信办于 7 月 31 日约谈英伟达，质疑其 H20 芯片存在“远程关闭与定位后门”的安全风险，并要求国内科技企业谨慎采购。央视随后将 H20 芯片定性为“不安全、不先进、不环保”的三不产品。此举加速了国内企业对国产 AI 芯片的替代进程，腾讯、阿里和百度等巨头均表示将减少对英伟达芯片的依赖，转向华为昇腾、寒武纪等国产解决方案³。2024 年中国 AI 芯片国产化率已飙升至 30%，出货量达 82 万张（较 2023 年翻倍），预计 2027 年国产 AI 芯片比例将达 55%。

(二) 经济指数

● 全球制造业 PMI 继续下滑至 49.7，全球需求疲软影响半导体产出

2025 年 7 月，全球制造业 PMI 录得 49.7，较 6 月的 50.3 出现下滑，再次跌破 50 的临界值，表明全球制造业活动略有恶化，显示出市场需求的进一步疲软。这一数据反映出全球经济的持续承压，特别是制造业中，产出、新订单、出口和就业均呈现下滑趋势，半导体行业的需求可能因此受到影响。

区域间差异较为明显：在亚洲市场，中国 PMI 为 49.3、韩国 PMI 为 48，均表现出持续收缩的状态，特别是在电子制造基地的生产和订单方面压力较大。而日本 PMI 为 49.9，略低于 6 月，但仍接近 50，显示出日本制造业略有回升。印度则继续表现强劲，PMI 高达 59.2，保持在高位增长，呈现出与其他地区截然不同的强劲势头。对于欧美市场，美国 PMI 为 48，欧元区 PMI 为 49.8，均较上月有所回落，反映出经济放缓的压力。

这种区域性差异为半导体需求带来了复杂的前景：印度和欧元区的回升可能促进内存、存储及一些通用芯片的需求增长，而中国、韩国等主要市场的持续收缩，可能意味着消费电子及智能设备的需求面临下行压力。对于半导体厂商而言，需要更加注重区域性市场动态，尤其是聚焦印度等增长潜力大的市场，以及欧美地区的温和复苏，同时谨慎应对亚洲市场的下行风险，采取更为灵活的应对策略。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10

2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80

数据来源：Wind

● 6 月全球半导体销售额创下新高，亚太地区表现强劲

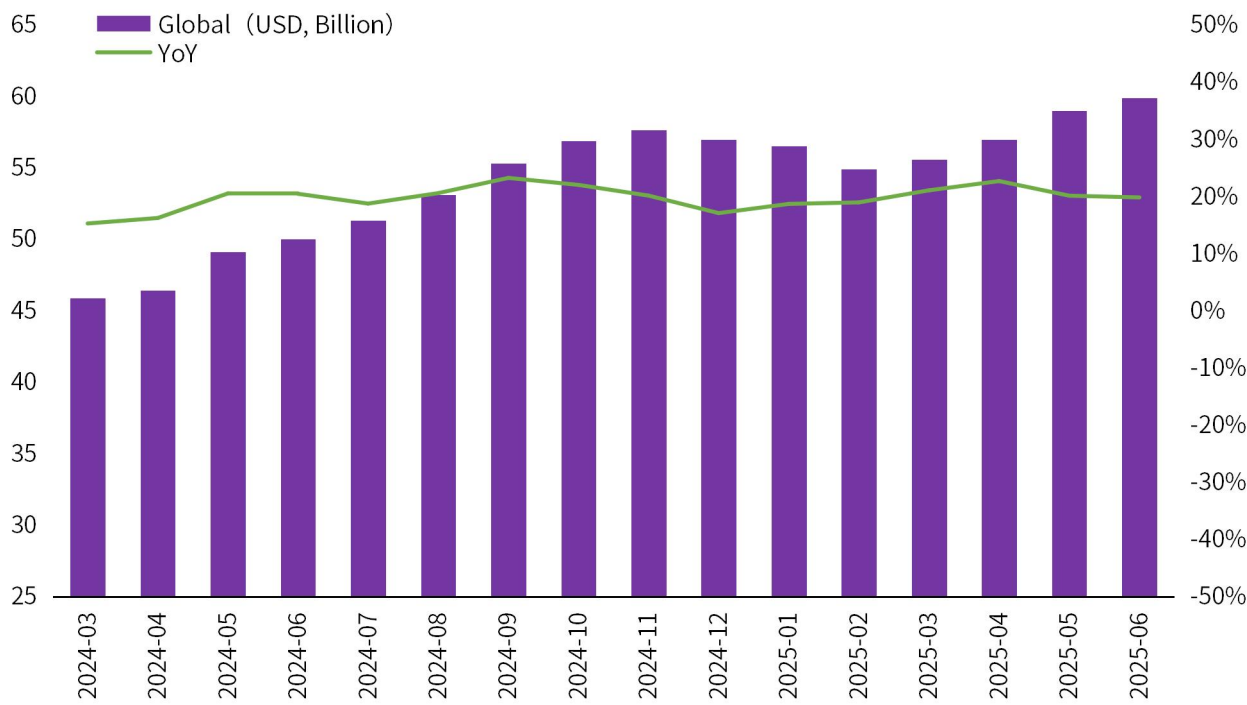
2025 年 6 月，全球半导体销售额达到了创纪录的 599 亿美元，同比增长 19.6%，环比增长 1.5%。这一增长主要得益于亚太地区的强劲表现，尤其是中国市场的稳定增长。尽管美洲和欧洲市场也有所增长，但增幅相对较小。具体而言，亚太及其他地区的销售额同比增长 34.2%，中国市场增长 13.1%，而美洲和欧洲分别增长 24.1%和 5.3%。然而，日本市场出现了 2.9%的同比下降，显示出该地区在全球半导体市场中的相对疲软。

环比数据也显示出积极的趋势，亚太及其他地区的销售额环比增长 5.8%，中国市场增长 0.8%，而美洲和欧洲市场则分别下降 0.2%和 0.7%。这些数据表明，尽管全球市场存在区域差异，但整体上半导体市场呈现出持续增长的态势。

需要注意的是，尽管全球销售额增长显著，但日本市场的表现相对疲软，可能受到国内需求疲软和国际贸易不确定性的影响。未来，全球半导体市场的增长可能会受到地缘政治和贸易政策变化的影响，尤其是在美国和中国之间的贸易摩擦持续的背景下。

总体而言，2025 年 6 月的销售数据反映出全球半导体市场的强劲增长，尤其是在亚太地区。随着人工智能、数据中心和高性能计算等领域的需求持续增长，预计全球半导体市场将在下半年继续保持增长势头。

全球半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

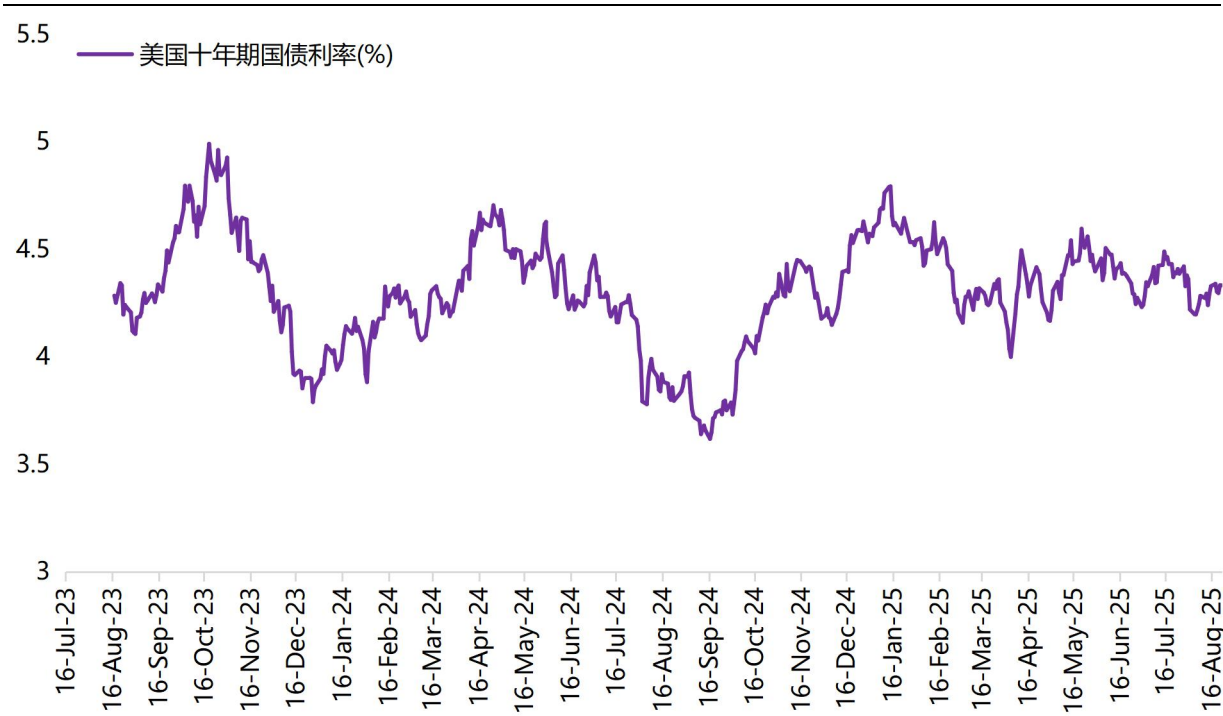
● 美国 10 年期国债收益率：7-8 月高位震荡，市场预期分化

2025 年 7 月至 8 月，美国 10 年期国债收益率持续在高位震荡，反映出市场对未来货币政策路径的高度关注。7 月 22 日，收益率一度升至 4.392%，随后在 7 月 29 日回落至 4.328%，8 月初再次反弹至 4.293%。截至 8 月 22 日，收益率稳定在 4.334% 附近。这一波动区间明显高于 2024 年初的 3.8% 和年中的 3.7%，但仍低于 2023 年末接近 5% 的峰值。

市场对美联储未来政策的预期出现分化。尽管 7 月和 8 月的就业数据疲软，增强了降息预期，但 7 月生产者价格指数（PPI）的上升加大了通胀压力，令市场对降息的预期产生疑虑。目前，市场对 9 月降息 25 个基点的概率约为 82%，但美联储主席鲍威尔强调，考虑到持续的通胀和稳健的劳动力市场，降息可能性仍有限。此外，政治压力和财政赤字的扩大也可能影响美联储的政策决策。

对于半导体产业而言，高位收益率可能带来融资成本上升的压力，影响资本支出和投资决策。因此，企业需密切关注宏观经济和政策动态，灵活调整战略以应对可能的市场变化。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源：Investing

● 费城半导体指数 7-8 月走势分析：高位震荡与市场信心考验

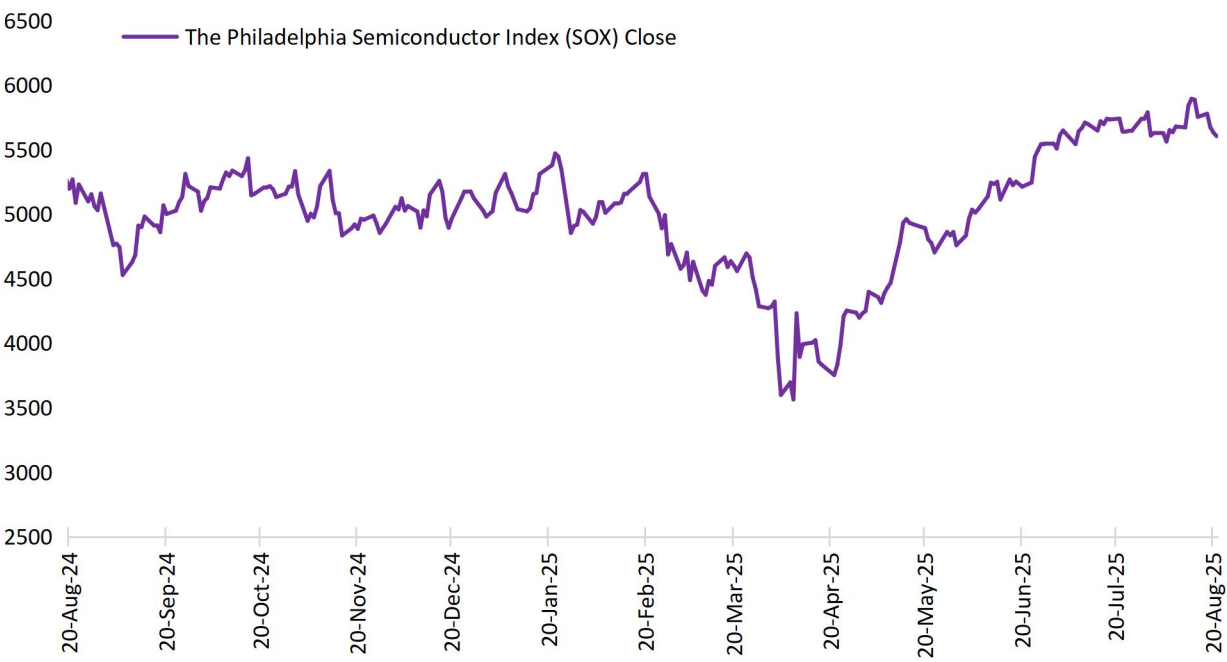
2025 年 7 月至 8 月，费城半导体指数（SOX）在经历了上半年的强劲上涨后，进入了调整阶段。7 月 31 日，指数收于 5,607.92 点，较 6 月末的 5,730.42 点略有下跌。进入 8 月后，指数继续震荡整理，8 月 21 日收于 5,603.26 点，较 7 月末略有下跌。

这一调整可能与多重因素有关。首先，市场对高估值的担忧加剧，尤其是在人工智能（AI）相关股票的估值过高的背景下。其次，宏观经济数据的疲软，如就业增长放缓和失业救济申请增加，可能引发市场对经济放缓的担忧。此外，市场对美联储货币政策的预期也可能影响投资者情绪。

尽管如此，半导体行业的基本面仍然强劲。全球对高性能芯片的需求持续增长，尤其是在 AI、云计算和汽车电子等领域。因此，尽管短期内市场可能面临压力，但长期来看，半导体行业仍然具有良好的增长前景。

投资者应关注宏观经济数据和美联储货币政策的变化，以评估市场走势。同时，建议关注半导体行业的基本面变化，识别长期投资机会。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	寒武纪/海光信息 Cambricon/Hygon	国产芯片概念股集体高开，市场情绪高涨	寒武纪、海光信息等国产芯片企业股价显著上涨，反映市场对国产算力前景的乐观预期
	三星电子 Samsung	HBM4 通过英伟达验证，计划 8 月底预生产	技术突破获得关键客户认可，提振市场信心，为抢占 AI 内存市场奠定基础
	SK 海力士 SK Hynix	HBM3E 需求爆发，营收贡献显著	AI 服务器需求持续拉动 HBM 等高端存储收入，公司业绩创下新高
	美光 Micron	裁员并削减成本，聚焦 HBM 与高毛利内存	美光通过裁员和成本优化，释放资源支持 HBM 和高端 DRAM 产品的生产，短期内有助于改善运营杠杆，提升交付能力。
	英伟达 NVIDIA	推出 Jetson AGX Thor 平台	新平台为机器人和边缘 AI 应用提供高算力支持，拓展应用领域。
中期影响	瑞萨电子 Renesas	发布 RZ/G3E MPU 与 RA8P1 MCU，面向工业/人机界面与高性能控制	平台更新强化生态锁定（RTOS/中间件/安全），中期扩大工业与白电份额
	DeepSeek	发布 DeepSeek-V3.1，明确支持 FP8 精度	FP8 精度适配下一代国产芯片，降低显存占用与算力成本，推动国产 AI 模型-芯片生态闭环落地
	微软 Microsoft	Windows 11 更新致部分 SSD “掉盘”	影响消费端 SSD 市场信心，加剧短期观望情绪，但对企业级存储市场影响有限
	意法半导体 STMicroelectronics	发布 Q2 业绩并重申收购 NXP 传感器条款，MEMS 维持两位数增长	Q2 营收略高于预期，模拟产品下滑，但 MEMS 实现两位数增长。公司收购 NXP 车载运动与压力传感器业务（9.5 亿美元），旨在增强汽车安全和工业传感器领域的竞争力。中期预计能提升 AMS 板块的利用率和毛利弹性。
	恩智浦 NXP	Q2 业绩优于预期，并推进传感器业务出售	NXP 出售部分传感器业务以专注于车载网络与电源管理领域，将进一步增强其资本回报与市场地位。

长期影响	华为 Huawei	实现麒麟芯片全产业链国产化	华为麒麟芯片的国产化意味着中国半导体产业在自主可控方面取得重大突破，长期来看将重塑全球半导体产业链格局。
	台积电 TSMC	两年内逐步退出 6 英寸产线、集中资源于 12 英寸与先进封装/制程	产能与资本向高附加值迁移，长期提升 ROIC 与技术护城河。
	英伟达 NVIDIA	Blackwell/Rubin 代际切换与中国区合规变体节奏，将重塑 AI 供应链配额	生态/软件/网络/内存协同升级，长期维持平台型优势，但对 HBM 产能依赖更深。

（一）短期影响

● 寒武纪/海光信息：市场情绪高涨，反映生态进步

2025 年 8 月 22 日，A 股市场的国产芯片概念股集体高开，寒武纪、海光信息等公司股价涨幅显著。短期来看，此轮上涨直接反映了市场对国产算力发展前景的普遍乐观预期。中期而言，这种市场情绪的背后，是国产 AI 模型（如 DeepSeek-V3.1）对国产芯片的主动适配、华为昇腾芯片在行业招投标中的积极参与等一系列实质性进展所支撑的产业自信。长期意义在于，资本市场的认可是产业发展的助推器，能为国产半导体企业提供更好的融资环境，加速技术研发和生态建设，进而巩固国产替代的长期趋势。

● 三星电子：HBM4 通过验证，技术追赶获关键进展

三星电子其 HBM4 产品已顺利通过英伟达的验证，并计划于 8 月底进入预生产阶段。短期内，此举极大地提振了市场对三星在 AI 内存领域追赶能力的信心。中期来看，成功切入英伟达供应链意味着三星将在未来的 AI 加速器市场中分得一杯羹，有望凭借其整体半导体制造优势，在 HBM4 时代改变目前由 SK 海力士主导的市场格局，其预计将占据约 30% 的市场份额。长期而言，HBM 作为 AI 算力的核心组件，此次突破为三星在未来的 AI 硬件竞争中夺回了重要的话语权。

● SK 海力士：HBM3E 需求强劲，业绩创历史新高

SK 海力士 2025 财年第二季度营收和营业利润均创下历史新高，这主要得益于面向人工智能（AI）的存储器（尤其是 HBM3E）销量增加。短期来看，其与“单一主要客户”（业内人士普遍认为是英伟达）的紧密合作是其业绩的核心驱动力。中期而言，凭借 HBM 产品的强劲表现，SK 海力士已成功抢占了相当大的 DRAM 市场份额。长期意义在于，与 AI 芯片巨头的深度绑定不仅带来了稳定的订单，更使其在 AI 浪潮中占据

了有利位置，有望持续享受 AI 发展带来的红利。

- **美光：裁员并削减成本，聚焦 HBM 与高毛利内存**

美光在 2025 年 8 月宣布实施裁员计划，并对成本进行优化。这一战略调整旨在集中资源于 HBM3E/HBM4 等高毛利内存产品的生产。短期内，这一举措将有助于改善公司的经营杠杆，提升供应链效率，并确保能够满足 AI 内存市场日益增长的需求。通过聚焦于高端内存的研发与生产，美光预计在保持毛利率的同时，减少低毛利产品对整体财务表现的拖累。

- **英伟达：推出的 Jetson AGX Thor 平台**

英伟达推出的 Jetson AGX Thor 平台为机器人和物理 AI 应用提供了前所未有的计算性能（2070 FP4 TFLOPS），这是其在边缘计算和 AI 领域的重要布局。短期内，这一平台将显著增强 AI 开发者的能力，特别是在边缘设备和低延迟计算需求日益增加的背景下。凭借其高效能和灵活性，Jetson AGX Thor 能够加速机器学习和物理 AI 任务的执行，尤其适用于自动驾驶、工业机器人等领域，满足市场对高性能 AI 计算解决方案的迫切需求。此外，平台的推出将在短期内推动更多开发者采用英伟达的硬件，进一步巩固其在 AI 硬件市场中的主导地位。英伟达此举不仅为边缘计算和物理 AI 应用提供了强有力的技术支持，也有望推动这些新兴领域在短期内实现更广泛的应用和快速增长。

（二）中期影响

- **Renesas 发布 RZ/G3E MPU 与 RA8P1 MCU，面向工业/人机界面与高性能控制**

7-8 月间，Renesas 连续发布嵌入式平台更新（RZ/G3E、RA8P1），覆盖工业控制、人机界面与高性能控制需求。中期强化生态（工具链/RTOS/安全/中间件），有助于扩大在工业/家电/楼宇等领域的份额；长期受益于平台化与长期供货策略。

- **DeepSeek：发布 V3.1 模型支持 FP8，推动国产 AI 芯片生态**

DeepSeek 于 2025 年 8 月发布了新一代大模型 DeepSeek-V3.1，并首次在国产芯片适配中引入 FP8 浮点精度方案。短期影响上，FP8 格式能将显存占用降低至 FP16 的 25%，直接降低了 AI 应用的部署和运行成本。中期意义在于，此举是国产 AI 软件生态主动适配国产硬件的关键一步，为摩尔线程等国产 GPU 厂商提供了明确的技术路径和生态支持，极大缩短了国产算力平台的落地周期。长期来看，此举旨在构建一个“国

产模型-国产芯片-国产系统”的技术闭环，是实现 AI 算力自主可控的重要战略举措，据行业测算，采用 FP8 方案后，数据中心综合成本可降低约 40%。

- **微软：Windows 11 更新致部分 SSD “掉盘”**

2025 年 8 月，微软的 Windows 11 更新引发部分 SSD “掉盘”问题，导致消费者对操作系统更新产生顾虑，特别是在消费端 SSD 市场，短期内可能加剧市场观望情绪，影响需求和信心。然而，企业级存储市场受影响较小，因其系统设计注重高稳定性与兼容性，不易受到此类问题的干扰。微软预计将发布补丁修复此问题，恢复用户信任并恢复消费市场信心。

- **意法半导体：发布 Q2 业绩并宣布收购 NXP 传感器**

ST 公布 Q2 营收 27.7 亿美元，略高于展望中点；功率/射频承压，但 MEMS 实现两位数增长。管理层强调以 9 亿美元+5000 万美元激励金收购 NXP 汽车运动与压力传感器业务，拟归入 AMS（模拟、MEMS 与传感器）板块，直指安全气囊、车辆动力学、胎压监测及工业压力/加速度计等高景气细分。该交易预计 2026 年上半年完成，中期有望提升传感器组合毛利与规模协同，并对 ST 在 ADAS、座舱与车内监控的传感矩阵形成补完。

- **恩智浦（NXP）Q2 EPS 略超预期，并出售 MEMS 传感器业务强化战略聚焦**

恩智浦第二季度营收约 29.3 亿美元，同比下降约 6% 但略超华尔街预期，非 GAAP 每股收益为 2.72 美元，略优于预测中点。与此同时，公司宣布以最高 9.5 亿美元全现金出售 MEMS 传感器业务给 STMicroelectronics，该业务在 2024 年产生约 3 亿美元营收，并具备较高利润水准。交易包括 9 亿美元的首付和 5000 万美元的里程碑支付，预计将于 2026 年上半年完成。

此项资产剥离旨在优化资本配置并提升运营专注度。中期来看，这将不仅释放现金流改善资产负债表，也使 NXP 能集中资源投入车载 SoC、车用网络与电源管理平台等核心高成长业务，从而提升资本回报率与战略护城河。

（三）长期影响

- **华为：麒麟芯片实现全产业链国产化**

华为成功实现麒麟芯片的全产业链国产化，标志着中国半导体产业在面对外部压力

时的重大突破。随着麒麟芯片完全依赖国内技术生产，华为在自给自足方面取得了长足进展，预计在未来几年内，华为将进一步巩固其在国内智能手机及 AI 领域的市场地位。这一变化对于中国半导体产业的独立性和全球产业链布局将产生深远影响，尤其是在全球科技产业中，中国的角色将愈加重要。

- **台积电：逐步退出 6 英寸产线，资源聚焦先进制程与封装**

台积电近日宣布将在未来两年内逐步退出其仅存的一条 6 英寸晶圆代工生产线，同时继续整合集成其四条 8 英寸生产产能，旨在提升整体运营效率并降低成熟制程单位成本。与此同时，公司仍保持其 12 英寸先进制程（如 N3/N4/N2）与 CoWoS 封装业务的强劲输出，满足苹果、英伟达等高端客户需求，并确保其财务和技术目标不受影响。此举反映出台积电对产能结构的战略性优化：长期来看，资本与生产资源不断向高附加值领域迁移，将稳固其技术护城河并显著提升资本回报率。

- **英伟达：Blackwell→Rubin 架构演进与中国市场合规策略**

英伟达正在推进新一代 GPU 架构由 Blackwell 向 Rubin 的技术迭代。Rubin GPU 将采用 TSMC 3nm 工艺，支持 HBM4 内存，并预计于 2026 年量产，性能可达 Blackwell 的多倍提升。与此同时，公司针对中国市场策略处于重塑期：推出合规款 AI 芯片（包括 H20 后续以及基于 Blackwell 的 B30A 和 RTX 6000D），以适应不断演变的出口政策与监管环境，努力在生态、软件、网络与内存协同上保持平台型优势。这种策略将在长期进一步夯实其“软硬件+网络+生态”的平台壁垒，同时也表明其对 HBM 内存产能依赖将更深——因为未来高级 AI 芯片的性能还将主要依赖 HBM 技术支撑。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	7-8 月市场动态
人工智能	AI 芯片	英特尔 Intel	获软银 20 亿美元投资，加码 AI 芯片与代工制造
	云计算与大数据	谷歌 Google	将在美追加 90 亿美元，扩建云计算与 AI 基础设施
新能源	光伏、储能	阳光电源 SUNGROW	拟在阿曼建设氢能电解槽工厂，布局中东氢能市场
	新能源汽车	长安汽车 CCAG	计划在欧洲建厂，加速全球化布局
消费电子	智能手机	小米 XIAOMI	发布 2025 年 Q2 财报，智能手机全球市场份额达 14.7%
	机器人	智元机器人 AgiBot	获富临精工数千万元订单，工业具身智能迈向规模化商用阶段
工业电子	工业自动化与控制	工业富联 Foxconn Industrial Internet	2025 上半年业绩创新高，净利润增长 38.6%
汽车电子	汽车产业链	豪恩汽电 Longhorn Auto	拟定增募资不超过 11.05 亿元，扩建深圳、惠州产线
通信电子	通信网络	中国移动 China Mobile	51.12 亿元 AI 推理设备集采落定，中兴通讯等企业中标
医疗电子	医疗影像设备	迈瑞医疗 Mindray	武汉基地正式开园，总投资达 45 亿元

（一）人工智能

- **英特尔获软银 20 亿美元投资，加码 AI 芯片与代工制造**

8 月 19 日，日本软银集团与英特尔签署最终协议，将以每股 23 美元的价格认购英特尔的普通股，总金额达 20 亿美元；交易完成后，软银将成为英特尔第五大股东，持股约 2%。英特尔表示，该笔资金将用于支持其在美国推进代工制造、AI 芯片研发及数字化转型计划。

- **谷歌将在美追加 90 亿美元，扩建云计算与 AI 基础设施**

8 月 14 日，谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊宣布，未来两年将在美国俄克拉何马州追加 90 亿美元投资，用于扩建云计算和 AI 基础设施，包括在斯蒂尔沃特市建新数据中心园区，以提升本土相关算力。此次投资部分纳入此前公布的 2025 年资本支出计划，其余来自未来项目。同时，谷歌将联合当地高校推出 AI 技能培训，助力相关就业。

（二）新能源

- **阳光电源拟在阿曼建设氢能电解槽工厂，布局中东氢能市场**

8 月 6 日，阳光电源股份有限公司宣布与阿曼签署备忘录，计划在当地建设氢能电解槽工厂，以助力阿曼绿色能源发展。据悉，阳光电源此前已成功中标阿曼 320MW 绿色合成氨项目的电解槽供货合同，成为该项目水电解制氢系统的最大份额供应商。此次布局将进一步深化其在中东氢能市场的参与，满足区域绿色氢能需求。

- **长安汽车计划在欧洲建厂，加速全球化布局**

据路透社报道，长安汽车近日计划在欧洲建厂，以支撑其未来在欧洲市场的销售。此前，长安汽车已推进欧洲市场拓展：今年 3 月，长安汽车宣布将在欧洲 10 个市场引入电动车，并在德国举办了品牌欧洲发布会；旗下深蓝 S07 今年在英国开售，9 月起交付。长安汽车已在全球规划 20 个海外工厂，埃及、巴西等多地工厂已投产，此次计划欧洲建厂将进一步推动其从产品出口迈向本地化生产的新阶段。

（三）消费电子

- **小米发布 2025 年 Q2 财报，智能手机全球市场份额达 14.7%**

8 月 19 日，小米集团发布 2025 年第二季度财报：智能手机全球市占率达 14.7%，

连续 20 个季度稳居全球前三。财报指出，小米旗下 4000–6000 元价位段出货量同比增长 38%，带动手机业务毛利率提升至 22.6%，高端化战略成效显著。基于强劲表现，小米将 2025 全年智能手机出货目标由 1.6 亿台上调至 1.75 亿台。

- **智元机器人获富临精工数千万元订单，工业具身智能迈向规模化商用阶段**

8 月 11 日，智元机器人与富临精工股份有限公司达成数千万元的项目合作，近百台远征 A2-W 机器人将落地富临精工工厂，这是国内首个工业领域具身机器人规模化商业签单案例，更是该品类在全球智能制造场景的首次规模化落地，标志着工业具身智能从技术验证阶段正式迈入规模化商用阶段。

(四) 工业电子

- **工业富联 2025 上半年业绩创新高，净利润增长 38.6%**

8 月 10 日，工业富联发布 2025 年半年度报告，业绩创同期历史新高：营收 3607.6 亿元，同比增长 35.6%；归母净利润 121.1 亿元，同比增长 38.6%，其中第二季度单季营收首超 2000 亿元、净利润 68.8 亿元，均同比增长且创新高。业绩增长主要受益于 AI 相关业务，上半年云计算业务中 AI 服务器营收增长显著，营收同比增超 60%。

(五) 汽车电子

- **豪恩汽电拟定增募资不超过 11.05 亿元，扩建深圳、惠州产线**

8 月 5 日晚，豪恩汽电披露定增预案，拟募资不超 11.05 亿元，用于深圳、惠州基地扩建产线建设以及研发中心升级项目，以提升汽车智能驾驶感知系统与域控制器产能。作为智能驾驶感知系统供应商，豪恩汽电的产品已嵌入上汽大众、一汽大众、比亚迪、小鹏、理想等主流车企供应链，此次扩产将提升其 3-4 倍的产能规划。

(六) 通信电子

- **中国移动 51.12 亿元 AI 推理设备集采落地，中兴通讯等企业中标**

8 月 18 日，中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中标候选人公示，新华三、中兴通讯、浪潮成为候选中标人，三个标包涉及金额合计约 17.31 亿元（含税）。加上此前公布的两个标包，该项目总体金额约达 51.12 亿元（含税），这也是 2025 年至今金额规模最大的 AI 服务器采购大单。

（七）医疗电子

- **迈瑞医疗武汉基地正式开园，总投资达 45 亿元**

8 月 5 日，总投资达 45 亿元的迈瑞医疗全球第二总部——迈瑞医疗武汉基地日前正式开园，将助力武汉打造生物医药和医疗器械产业集群。基地计划 5 年内吸纳 2000 名员工，其中研发人才占比 60%，预计将带动超百家配套企业聚集，助力武汉 2030 年大健康产业规模突破 8000 亿元。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2025 年 8 月存储芯片重点产品行情一览

产品	代表型号	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	8GB	上涨	——	紧张
DDR5	16GB	上涨	——	平衡
NAND Flash	128GB	上涨	6-10	紧张
eMMC	32GB	上涨	8-12	紧张
HBM 高带宽 内存	HBM3E	上涨	52+	紧张

数据来源：EET China、TrendForce、AnandTech、行业现货报价

● 8 月存储芯片全线涨价，供给端呈现结构性调整

1) 产品动态

- **DDR4**：由于头部 DRAM 大厂计划停产 DDR4 转向 DDR5，市场预期供应减少，现货月环比再涨 15-20%；全年累计涨幅已超 50%。
- **DDR5**：价格也在上涨，但相对温和，涨幅 5%，AI PC 与服务器需求持续放量。
- **NAND Flash**：价格波动中企稳回升，预计将维持在全年平均水平；2025 年第二季度，NAND Flash 价格较第一季度有 0- 5%的涨幅预期。
- **eMMC**：因部分原厂供应策略调整，释放部分 MLC NAND 资源给下游存储厂商，导致部分低容量 eMMC 产品价格大幅走高，如 8GB、16GB、32GB eMMC 价格可能与 64GB eMMC 出现全面倒挂。
- **HBM**：SK 海力士计划提高 HBM4 售价，今年上半年供应给英伟达的 12 层堆叠 HBM4 单价约为 500 美元，相较同规格 HBM3E（约 300 美元）高出 60%-70%。

2) 市场趋势

- **行业增长潜力大：**存储芯片行业正经历关键性转折，迎来复苏周期。人工智能、高性能计算及数据中心等领域的旺盛需求，成为推动存储芯片行业景气度提升的重要因素。随着 AI、云计算等领域需求持续释放，存储芯片市场规模有望扩大。
- **产业格局调整：**DRAM 产能转向 HBM/DDR5，传统 DDR4、NAND 小容量成短缺重灾区。行业集中度可能进一步提升，具备核心技术储备及全球化供应能力的企业将占据优势。三星、SK 海力士、美光等国际巨头将业务重心转向 HBM 等高端产品线，削减 DDR4 及移动端 LPDDR4X 产品供应量。

(二) GPU

2025 年 8 月 GPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	厂商	价格趋势	交期（周）	供需状态
消费级	RTX 5090	英伟达 (NVIDIA)	下降	4-6	缓解
	RX 9070 XT	超威半导体 (AMD)	上涨	4-8	平衡
	Ada Loveless 系列	英伟达 (NVIDIA)	上涨	——	即将 EOL (2026 下)
数据中心	H100/H200	英伟达 (NVIDIA)	上涨	20+	紧缺
	AMD MI300X	超威半导体 (AMD)	下降	12-16	缓解
	Blackwell 200/4000/5000 系列	英伟达 (NVIDIA)	上涨	预计 9 月或更晚	紧缺
缓存显存组件	GDDR6 显存	——	上涨	6-8	紧缺

数据来源：Jon Peddie Research、DigiTimes、供应链渠道调研

- **产品迭代加速，AI GPU 租赁与替代趋势显著**

- 1) **产品动态**

- **消费级：**英伟达 RTX 5090 显卡价格在 8 月继续下调，交期约 4-6 周，供需状态有所缓解；AMD 的 RX 9070 XT 则因市场需求走强而价格上涨，交期在 4-8 周之间，整体供需保持平衡。此外，英伟达宣布 Ada Lovelace 系列将于 2026 年下半年进入 EOL（停产）阶段，意味着下一代产品迭代节奏加快。
- **数据中心：**英伟达 H100/H200 GPU 价格继续上行，H200 供应仍紧张，交期超过 20 周；AMD MI300X 价格有所下调，交付周期在 12-16 周，市场供应较前期趋于宽松。英伟达的 Blackwell 系列（200/4000/5000）芯片交期预计将延后至 9 月或更晚，显示高性能 GPU 在 AI 和大模型计算市场需求依旧旺盛。
- **存储组件：**GDDR6 显存供应持续紧张，交期维持在 6-8 周，高性能显卡和 AI 加速卡的持续需求推高了该组件的交付周期。

市场趋势

- **产品生命周期调整：**英伟达加快产品迭代，计划在 2026 年下半年逐步淘汰 Ada Lovelace 架构，并推动 Blackwell 架构加速渗透，尤其是在云计算和 AI 推理场景中的应用。
- **国产替代加速推进：**英伟达 H20 停产加速了国内企业在 AI 芯片领域的自主研发步伐。在 2025 中国算力大会上，业内预计 2025 年中国 GPU 市场规模将突破千亿元，数据中心和边缘计算成为主要增量来源。

(三) CPU

2025 年 8 月 CPU 重点产品行情一览

产品	代表型号	厂商	价格趋势	核心/线程	交期/周
消费级	i5-13400F	英特尔 (Intel)	上涨	10-16	3-7
	R9 9950X3D	超威半导体 (AMD)	下降	16-32	7-10
	第 13 代移动 CPU	英特尔 (Intel)	下降	——	——
	Ryzen 8000G	超威半导体 (AMD)	下降	含 NPU	——
服务器	至强 6980	英特尔 (Intel)	下降	128	——
	EPYC 9845	超威半导体 (AMD)	下降	160	——
	Emerald Rapids 系列	超威半导体 (AMD)	稳定	多核心	——
	EPYC Turin / Genoa (9005 系列)	超威半导体 (AMD)	下降	高核心 (64-192 核)	——

● 服务器 CPU 压力攀升启动价格战，消费级市场供需分化

1) 产品动态

- **消费级：**英特尔 Core i5-13400F 价格略有上涨，交期保持在 3-7 周；相比之下，AMD R9 9950X3D 出现小幅降价，交期约为 7-10 周，反映出两家厂商在中高端桌面市场上的策略分歧。英特尔第 13 代移动处理器（Raptor Lake）供货逐步改善，缓解了部分高频需求；而 AMD 的 Ryzen 8000G 系列，因集成 NPU 且供给依然紧张，仍然存在供不应求现象。
- **服务器：**英特尔 Xeon 至强 6980（Granite Rapids）和 AMD EPYC 9845 均经

历明显价格下调，但交期尚稳定，表明两家厂商在为下一代产品铺货过程中进行库存调整。Emerald Rapids 和 Sapphire Rapids 系列交货处于紧张状态，数据中心对新一代服务器 CPU 的需求依旧旺盛。AMD 的 EPYC Turin 与 Genoa (9005 系列) 产品需求持续上升，交期不断延长，进一步拉高企业采购的紧迫性。

2) 市场趋势

- **价格战升级与技术迭代加速：**为应对市场竞争，英特尔与 AMD 高端服务器 CPU 当前出现高达 50% 的降价，例如 Xeon 6980P 和 EPYC 9965 出现显著折扣，促使企业提前更新换代。此外，英特尔已确认将在 2026 年推出 Diamond Rapids (P-Core) 与 Clearwater Forest (E-Core) 等 Xeon 6 系列新产品，增强能效与 AI 加速能力；而 AMD 则凭借强大的 EPYC Turin / Genoa 架构，继续巩固其在高核心、高性能服务器市场的领先地位。
- **AI 与网络边缘融合趋势明显：**英特尔 Xeon 6 SoC 可在 AI 和 5G 网络核心场景中提升 2.4 倍 RAN 容量和 70% 性能功耗比；NPU 集成已成为 CPU 标配趋势。
- **供应不确定性延续至年底：**半导体产业链压力让 CPU 紧缺态势预计持续至 2025 年底，企业采购需提前规划以应对供给延误。

信息来源

- [1] Advisor Perspectives. "S&P Global US Manufacturing PMI™ : First Contraction of 2025," Advisor Perspectives, August 1, 2025.
- [2] Evertiq. "Global Semiconductor Sales Increase 7.8% from Q1 to Q2," Evertiq, August 14, 2025.
- [3] Federal Reserve Bank of St. Louis. "Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis," Federal Reserve Bank of St. Louis, August 20, 2025.
- [4] PR Newswire. "July 2025 Manufacturing ISM® Report On Business," PR Newswire, July 1, 2025.
- [5] S&P Global. "Monthly PMI Bulletin: July 2025," S&P Global, July 1, 2025.
- [6] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor Sales Increase 7.8% from Q1 to Q2," Semiconductor Industry Association (SIA), June 5, 2025.
- [7] Trading Economics. "United States Manufacturing PMI," Trading Economics, July 1, 2025.
- [8] U.S. Department of the Treasury. "Daily Treasury Par Yield Curve Rates," U.S. Department of the Treasury, August 20, 2025.
- [9] Trump, Donald. "U.S. to Impose High Tariffs on Imported Semiconductors, Rates Could Reach 300%," Reuters, 2025.
- [10] Lutnick, Howard. "U.S. Government Considers Equity-for-Subsidies Plan for Semiconductor Giants," Wall Street Journal, 2025.
- [11] NVIDIA. "Jetson AGX Thor Platform Released for Robotics and Physical AI Applications," NVIDIA Official Press Release, 2025.
- [12] Microsoft. "Windows 11 Update Issues Impacting SSD Performance," Microsoft Support, 2025.
- [13] IDC. "Consumer Storage Market Trends and SSD Adoption," IDC Research Report, 2025.
- [14] Western Digital. "Impact of Windows 11 on Consumer SSD Sales," Western Digital Official Announcement, 2025.
- [15] 深圳市工业和信息化局. "深圳市发布高端装备产业发展扶持计划，重点支持半

导体设备领域", 深圳经济日报, 2025。

[16] 江苏省人民政府. "江苏省发布 2025 年首批次新材料认定结果, 其中涉及半导体材料", 江苏新闻, 2025。

[17] 深圳市工业和信息化局. "深圳市高端装备产业发展扶持计划操作规程, 半导体设备获资助", 深圳市政府官网, 2025。

[18] 美光科技. "宣布裁员并削减成本, 以聚焦 HBM 与高毛利内存," 美光科技官方新闻稿, 2025 年。

[19] 新浪财经. "寒武纪、海光信息等国产芯片概念股高开," 新浪财经, 2025 年。

[20] 财经网. "三星电子: HBM4 通过验证, 技术追赶获关键进展," 财经网, 2025 年。

[21] 证券时报网. "SK 海力士: HBM3E 需求强劲, 业绩创历史新高," 证券时报网, 2025 年。

[22] 美光. "美光: 裁员并削减成本, 聚焦 HBM 与高毛利内存," 美光官网, 2025 年 8 月 22 日。

[23] Renesas. "Renesas 发布 RZ/G3E MPU 与 RA8P1 MCU, 面向工业/人机界面与高性能控制," Renesas 官网, 2025 年。

[24] DeepSeek. "DeepSeek: 发布 V3.1 模型支持 FP8, 推动国产 AI 芯片生态," DeepSeek 官方博客, 2025 年。

[25] STMicroelectronics. "意法半导体: 发布 Q2 业绩并宣布收购 NXP 传感器," STMicroelectronics 官网, 2025 年。

[26] NXP. "恩智浦 (NXP) Q2 EPS 略超预期, 并出售 MEMS 传感器业务强化战略聚焦," NXP 官网, 2025 年。

[27] 华为. "华为: 麒麟芯片实现全产业链国产化," 华为官网, 2025 年 8 月 22 日。

[28] 台积电. "台积电: 逐步退出 6 英寸产线, 资源聚焦先进制程与封装," 台积电官网, 2025 年。

[29] NVIDIA. "英伟达: Blackwell→Rubin 架构演进与中国市场合规策略," NVIDIA 官网, 2025 年。

[30] 软银集团拟 20 亿美元入股英特尔 或成后者第五大股东证券时报网, 2025

[31] 寒武纪的 4000 亿之问, 价值新章还是泡沫狂欢? , 新浪财经, 2025

[32] 谷歌将在美再投资 90 亿美元 用以扩建云计算和 AI 基础设施, 财联社

[33] 阳光电源拟在阿曼建氢能电解槽工厂, 新浪财经, 2025

- [34] 长安汽车拟在欧洲建厂，布局海外市场，太平洋汽车，2025
- [35] 小米营收连续 3 个季度超千亿元 汽车业务预计下半年盈利，证券时报
- [36] 这家上市公司，在芜湖布局超级工厂暨全球总部！澎湃新闻
- [37] 密集对外投资、规模化商业接单！智元机器人的商业化新突破，财联社
- [38] 7000 亿 AI 龙头，上半年业绩创新高，中国证券报，2025
- [39] 豪恩汽电增长乏力净利率三连降 拟募 11 亿扩产押注 10 倍增长空间
- [40] 迈瑞医疗全球第二总部在汉开园，300%增资“追投”武汉，武汉市人民政府
- [41] 迈瑞医疗武汉基地开园 总投资额 45 亿元，金融界
- [42] 2025 年中国存储芯片市场分析及重点企业表现——数据透视行业动态与趋势
- [43] 存储芯片迎来复苏周期，NAND 和 DRAM 价格企稳回升，金融界
- [44] 2025 年 GPU 统计数据及发展趋势：半导体设备国产替代加速
- [45] 2025 年 8 月显卡市场观察：性能激增与选择困境
- [46] TI 发布涨价通知！超 6 万料号集体提价 10%-30%
- [47] AMD 与 Intel 服务器 CPU 价格激战，部分型号直降 50%

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

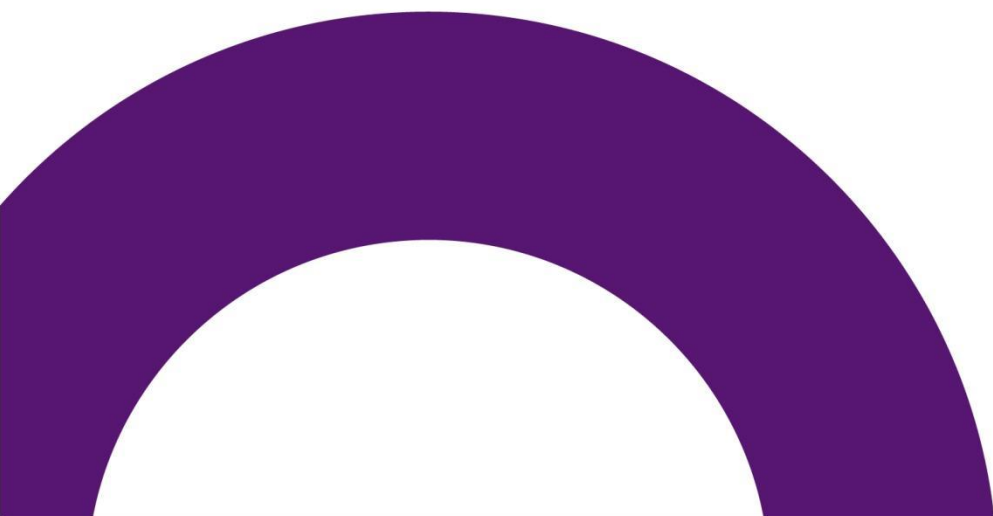
安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 8 月

360iC 安芯易



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

